

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 2 部門第 4 区分

【発行日】平成28年5月26日 (2016.5.26)

【公開番号】特開2014-201060(P2014-201060A)

【公開日】平成26年10月27日 (2014.10.27)

【年通号数】公開・登録公報2014-059

【出願番号】特願2013-88810(P2013-88810)

【国際特許分類】

**B 3 2 B 15/04 (2006.01)**

**H 0 5 K 3/38 (2006.01)**

【 F I 】

B 3 2 B 15/04 A

H 0 5 K 3/38 B

【手続補正書】

【提出日】平成28年3月30日 (2016.3.30)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

銅箔キャリアと、銅箔キャリア上に積層された中間層と、中間層の上に積層された極薄銅層とを備えたキャリア付銅箔であって、

前記中間層は Ni を含み、

重量厚み法にて測定した前記極薄銅層の厚み精度が 3 . 0 % 以下であり、

前記キャリア付銅箔を 220 で 2 時間加熱した後、J I S C 6471 に準拠して前記極薄銅層を剥がしたとき、前記極薄銅層の前記中間層側の表面の Ni の付着量が  $5 \mu\text{g} / \text{dm}^2$  以上  $300 \mu\text{g} / \text{dm}^2$  以下であるキャリア付銅箔。

【請求項 2】

銅箔キャリアと、銅箔キャリア上に積層された中間層と、中間層の上に積層された極薄銅層とを備えたキャリア付銅箔であって、

前記中間層は Ni を含み、

四探針法にて測定した前記極薄銅層の厚み精度が 10 . 0 % 以下であり、

前記キャリア付銅箔を 220 で 2 時間加熱した後、J I S C 6471 に準拠して前記極薄銅層を剥がしたとき、前記極薄銅層の前記中間層側の表面の Ni の付着量が  $5 \mu\text{g} / \text{dm}^2$  以上  $300 \mu\text{g} / \text{dm}^2$  以下であるキャリア付銅箔。

【請求項 3】

以下の ( A ) ~ ( C ) のいずれか一つを満たす請求項 1 又は 2 に記載のキャリア付銅箔

( A ) 前記極薄銅層の表面に粗化処理層を有する、

( B ) 前記極薄銅層の表面に粗化処理層を有し、かつ、前記粗化処理層の表面に、耐熱層、防錆層、クロメート処理層及びシランカップリング処理層からなる群から選択された 1 種以上の層を有する、

( C ) 前記極薄銅層の表面に、耐熱層、防錆層、クロメート処理層及びシランカップリング処理層からなる群から選択された 1 種以上の層を有する。

【請求項 4】

前記極薄銅層上または前記粗化処理層上または前記耐熱層、防錆層、クロメート処理層

及びシランカップリング処理層からなる群から選択された１種以上の層の上に樹脂層を備える請求項１～３のいずれかに記載のキャリア付銅箔。

【請求項５】

請求項１～４のいずれかに記載のキャリア付銅箔を用いてプリント配線板を製造する方法。

【請求項６】

請求項１～４のいずれかに記載のキャリア付銅箔を用いて銅張積層板を製造する方法。

【請求項７】

請求項１～４のいずれかに記載のキャリア付銅箔と絶縁基板とを準備する工程、  
前記キャリア付銅箔と絶縁基板とを積層する工程、及び、  
前記キャリア付銅箔と絶縁基板とを積層した後に、前記キャリア付銅箔のキャリアを剥がす工程を経て銅張積層板を形成し、  
その後、セミアディティブ法、サブトラクティブ法、パートリーアディティブ法又はモディファイドセミアディティブ法のいずれかの方法によって、回路を形成する工程を含むプリント配線板の製造方法。